

<<电子工艺基础>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺基础>>

13位ISBN编号：9787121122804

10位ISBN编号：7121122804

出版时间：2011-6

出版时间：电子工业出版社

作者：王卫平

页数：385

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子工艺基础>>

内容概要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，根据国家大力发展制造业，教委关于推动高校生产实训基地建设，培养应用型、技能型人才的需求编写的。

本书从电子整机产品制造工艺的实际出发，介绍常用电子元器件和材料、印制电路板的设计与制作、表面装配技术、整机的结构及质量控制、生产线的组织与管理等。

全书共8章，每章均附有思考与习题。

通过学习这些内容，有助于读者掌握生产操作的基本技能，又能够站在工艺工程师和工艺管理人员的角度认识生产的全过程，充分了解工艺工作在电子产品制造过程中的重要地位。

<<电子工艺基础>>

书籍目录

第1章 电子工艺技术和工艺管理

- 1.1 工艺概述
- 1.2 电子产品制造工艺工作程序
- 1.3 电子产品制造工艺的管理
- 1.4 电子产品工艺文件

思考与习题

第2章 电子元器件

- 2.1 电子元器件的主要参数
- 2.2 电子元器件的检验和筛选
- 2.3 电子元器件的命名与标注
- 2.4 常用元器件简介
- 2.5 表面组装 (SMT) 元器件

思考与习题

第3章 电子产品组装常用工具及材料

- 3.1 电子产品组装常用五金工具
- 3.2 焊接工具
- 3.3 焊接材料
- 3.4 制造印制电路板的材料——覆铜板
- 3.5 常用导线与绝缘材料
- 3.6 其他常用材料

思考与习题

第4章 印制电路板的设计与制作

- 4.1 印制电路板的排版设计
- 4.2 印制电路板上的焊盘及导线
- 4.3 SMT印制电路板的设计
- 4.4 制板技术文件
- 4.5 印制电路板的制造工艺简介
- 4.6 印制电路板的计算机辅助设计
- 4.7 自制印制板的简易方法

思考与习题

第5章 装配焊接及电气连接工艺

第6章 电子组装设备与组装生产线

第7章 电子产品的整机结构与技术文件

第8章 电子产品制造企业的质量控制与认证

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>